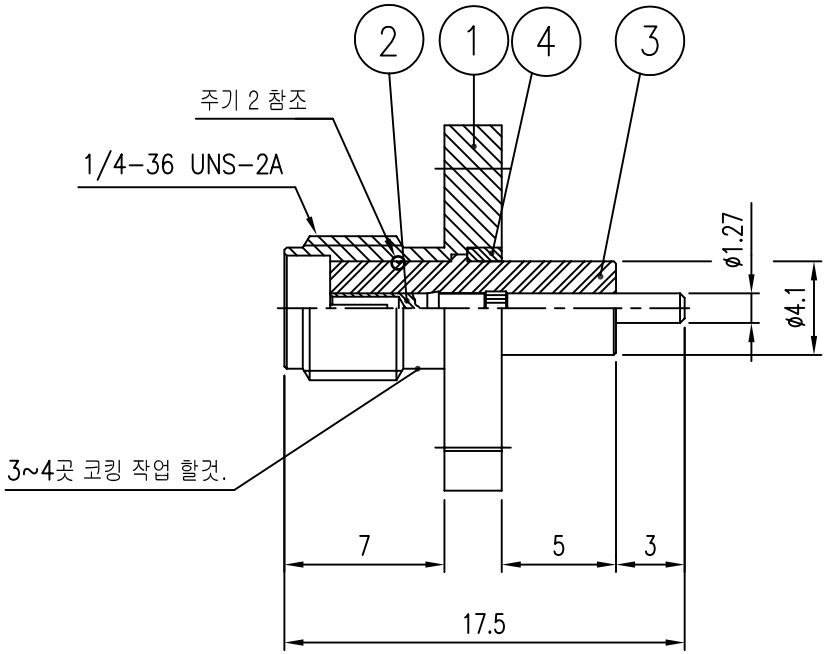
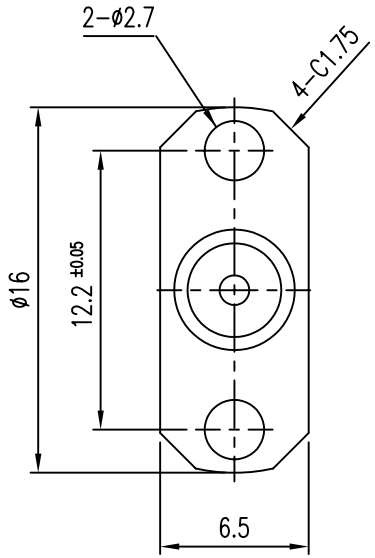
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일





품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
4	고정링	1	MBsBD	Nickel Plate	DCV00034-5/1(L2043)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01092-N/1(H2360)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01423-5/1(E2538)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01978-5/1

주 기

1. 회전 토크 7Kgf 이상 일 것.
2. 절연체 삽입시 V 홈 부위가 앞부분임.

대체가능재질	년월일	2008. 5. 08.	KJ COMTECH KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	승인		
	검도		도명 SMA-J-H4-R VER.0
재질	제도		
열처리	작성부서	연 구 소	A4 도번 CN01998-7/1
보호피막처리	척도 1.5/1	단위 mm	중량